

## 部品内蔵基板の歩みと今後の課題

見山 克己\*

Circumstances of Developing Device Embedded Substrate and Its Future Subjects

Katsumi MIYAMA\*

---

\* 北海道科学大学工学部機械工学科 (〒 006-8585 札幌市手稲区前田 7 条 15 丁目 4-1)

\* Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Hokkaido University of Science (7-15, Maeda Teine-ku, Sapporo, Hokkaido 006-8585)